

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年3月9日(09.03.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/032930 A1

(51) 国際特許分類:

H01L 21/304 (2006.01) C09G 1/02 (2006.01)
B24B 37/00 (2012.01) C09K 3/14 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2022/032453

(22) 国際出願日: 2022年8月29日(29.08.2022)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:

PCT/JP2021/031894 2021年8月31日(31.08.2021) JP
PCT/JP2021/031892 2021年8月31日(31.08.2021) JP
特願 2022-088818 2022年5月31日(31.05.2022) JP

(71) 出願人: 株式会社 レゾナック (RESONAC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1058518 東京都港区芝大門一丁目13番9号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 荒田 彰吾 (ARATA Shogo); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP). 市毛 康裕 (ICHIGE Yasuhiro); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 昭和電工マテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,

HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: POLISHING LIQUID, POLISHING METHOD, COMPONENT MANUFACTURING METHOD, AND SEMICONDUCTOR COMPONENT MANUFACTURING METHOD

(54) 発明の名称: 研磨液、研磨方法、部品の製造方法、及び、半導体部品の製造方法

(57) Abstract: This polishing liquid contains cerium oxide abrasive grains and ammonium salt, and has a pH of at least 9.00. This polishing method uses the polishing liquid to polish a member to be polished that contains copper. This component manufacturing method enables a component to be obtained by using the member to be polished which has been polished using the polishing method. This semiconductor component manufacturing method enables a semiconductor component to be obtained by using the member to be polished which has been polished using the polishing method.

(57) 要約: セリウム酸化物を含む砥粒と、アンモニウム塩と、を含有し、pHが9.00以上である、研磨液。前記研磨液を用いて、銅を含有する被研磨部材を研磨する、研磨方法。前記研磨方法により研磨された被研磨部材を用いて部品を得る、部品の製造方法。前記研磨方法により研磨された被研磨部材を用いて半導体部品を得る、半導体部品の製造方法。



WO 2023/032930 A1

明 細 書

発明の名称：

研磨液、研磨方法、部品の製造方法、及び、半導体部品の製造方法

技術分野

[0001] 本開示は、研磨液、研磨方法、部品の製造方法、半導体部品の製造方法等に関する。

背景技術

[0002] 近年の電子デバイスの製造工程では、高密度化、微細化等のための加工技術の重要性がますます高まっている。加工技術の一つであるCMP（ケミカル・メカニカル・ポリッシング：化学機械研磨）技術は、電子デバイスの製造工程において、シャロートレンチ分離（シャロー・トレンチ・アイソレーション：STI）の形成、プリメタル絶縁材料又は層間絶縁材料の平坦化、プラグ又は埋め込み金属配線の形成等に必須の技術となっている。CMPに用いられる研磨液としては、セリウム酸化物を含む砥粒を含有する研磨液が知られている（例えば、下記特許文献1及び2参照）。

先行技術文献

特許文献

[0003] 特許文献1：特開平10-106994号公報
特許文献2：特開平08-022970号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0004] CMPに用いることが可能な研磨液に対しては、銅を含有する被研磨部材を研磨して早期に除去することが求められる場合がある。このような研磨液に対しては、銅の研磨速度を向上させることが求められる。

[0005] 本開示の一側面は、銅の研磨速度を向上させることが可能な研磨液を提供することを目的とする。本開示の他の一側面は、前記研磨液を用いた研磨方法を提供することを目的とする。本開示の他の一側面は、前記研磨方法を用

いた部品の製造方法を提供することを目的とする。本開示の他の一側面は、前記研磨方法を用いた半導体部品の製造方法を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0006] 本開示は、いくつかの側面において、下記の [1] ~ [17] 等に関する。

[1] セリウム酸化物を含む砥粒と、アンモニウム塩と、を含有し、pHが9.00以上である、研磨液。

[2] 前記アンモニウム塩が炭酸アンモニウムを含む、[1]に記載の研磨液。

[3] 前記アンモニウム塩が過硫酸アンモニウムを更に含む、[2]に記載の研磨液。

[4] 前記アンモニウム塩の含有量が0.3~2質量%である、[1]~[3]のいずれか一つに記載の研磨液。

[5] アンモニアを更に含有する、[1]~[4]のいずれか一つに記載の研磨液。

[6] ヒドロキシ基を有するエーテル化合物を更に含有する、[1]~[5]のいずれか一つに記載の研磨液。

[7] 前記エーテル化合物がアルコキシアルコールを含む、[6]に記載の研磨液。

[8] 前記アルコキシアルコールが3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノールを含む、[7]に記載の研磨液。

[9] 前記アルコキシアルコールの含有量が、研磨液の全質量を基準として0.2~0.8質量%である、[7]又は[8]に記載の研磨液。

[10] 前記エーテル化合物が、2つ以上のヒドロキシ基を有する化合物を含む、[6]~[9]のいずれか一つに記載の研磨液。

[11] 前記エーテル化合物がポリエーテルを含む、[6]~[10]のいずれか一つに記載の研磨液。

[12] 前記ポリエーテルがポリグリセリンを含む、[11]に記載の研磨

液。

[13] 前記ポリエーテルの含有量が、研磨液の全質量を基準として0.5～3質量%である、[11]又は[12]に記載の研磨液。

[14] pHが9.00～11.00である、[1]～[13]のいずれか一つに記載の研磨液。

[15] [1]～[14]のいずれか一つに記載の研磨液を用いて、銅を含有する被研磨部材を研磨する、研磨方法。

[16] [15]に記載の研磨方法により研磨された被研磨部材を用いて部品を得る、部品の製造方法。

[17] [15]に記載の研磨方法により研磨された被研磨部材を用いて半導体部品を得る、半導体部品の製造方法。

発明の効果

[0007] 本開示の一側面によれば、銅の研磨速度を向上させることが可能な研磨液を提供することができる。本開示の他の一側面によれば、前記研磨液を用いた研磨方法を提供することができる。本開示の他の一側面によれば、前記研磨方法を用いた部品の製造方法を提供することができる。本開示の他の一側面によれば、前記研磨方法を用いた半導体部品の製造方法を提供することができる。本開示の他の一側面によれば、銅を含有する被研磨部材の研磨への研磨液の応用を提供することができる。

発明を実施するための形態

[0008] 以下、本開示の実施形態について説明する。但し、本開示は下記実施形態に限定されるものではない。

[0009] 本明細書において、「～」を用いて示された数値範囲は、「～」の前後に記載される数値をそれぞれ最小値及び最大値として含む範囲を示す。数値範囲の「A以上」とは、A、及び、Aを超える範囲を意味する。数値範囲の「A以下」とは、A、及び、A未満の範囲を意味する。本明細書に段階的に記載されている数値範囲において、ある段階の数値範囲の上限値又は下限値は、他の段階の数値範囲の上限値又は下限値と任意に組み合わせることができ

る。本明細書に記載されている数値範囲において、その数値範囲の上限値又は下限値は、実施例に示されている値に置き換えてもよい。「A又はB」とは、A及びBのどちらか一方を含んでいればよく、両方とも含んでいてもよい。本明細書に例示する材料は、特に断らない限り、1種を単独で又は2種以上を組み合わせて用いることができる。組成物中の各成分の含有量は、組成物中に各成分に該当する物質が複数存在する場合、特に断らない限り、組成物中に存在する当該複数の物質の合計量を意味する。「膜」との語は、平面図として観察したときに、全面に形成されている形状の構造に加え、一部に形成されている形状の構造も包含される。「工程」との語は、独立した工程だけではなく、他の工程と明確に区別できない場合であってもその工程の所期の作用が達成されれば、本用語に含まれる。「アルキル基」は、特に断らない限り、直鎖状、分岐又は環状のいずれであってもよい。「砥粒」とは、複数の粒子の集合を意味するが、便宜的に、砥粒を構成する一の粒子を砥粒と呼ぶことがある。

[0010] <研磨液>

本実施形態に係る研磨液は、セリウム酸化物を含む砥粒と、アンモニウム塩と、を含有し、pHが9.00以上である。本実施形態に係る研磨液は、CMP研磨液として用いることができる。

[0011] 本実施形態に係る研磨液によれば、銅の研磨速度を向上させることが可能であり、後述の実施例に記載の評価方法において例えば $0.35\mu\text{m}/\text{min}$ 以上（好ましくは $0.40\mu\text{m}/\text{min}$ 以上）の研磨速度を得ることができる。銅の研磨速度が向上する要因は必ずしも明らかではないが、本発明者は、下記のとおりであると推測している。すなわち、アンモニウム塩、又は、アンモニウム塩のアンモニウムカチオンが銅と錯体を形成すると共に、砥粒のセリウム酸化物の酸化力が作用してこの錯体の形成が促進されることにより、銅の研磨速度が向上すると推測される。但し、効果が得られる要因は当該内容に限定されない。

[0012] 本実施形態に係る研磨液は、銅を含有する被研磨部材の研磨に用いること

ができる。本実施形態に係る研磨液は、銅を含有する被研磨部材以外の被研磨部材の研磨に用いてもよい。

[0013] 近年、電子デバイスの高速化、低消費電力化、大容量化等の観点から、2.1D集積回路、2.5D集積回路、3D集積回路等の開発が進められており、chip-to-chip、wafer-to-wafer、chip-to-wafer等の接続工程、及び、WLP (Wafer-Level Packaging)、PLP (Panel-Level Packaging) 等による半導体パッケージの製造工程への関心が高まっている。これらの工程において良好な接続面（ここでは、直接に接続される面のみならず、他の部材を介して接続される場合の下地となる面も「接続面」と呼称する）を得るために平坦化することが求められる被研磨部材の被研磨面には、樹脂（例えばエポキシ樹脂）及び金属材料（例えば銅）が存在する場合がある。本実施形態に係る研磨液は、樹脂（例えばエポキシ樹脂）及び金属材料（例えば銅）を含有する被研磨部材を研磨するために用いてよい。

[0014] 本実施形態に係る研磨液は、セリウム酸化物を含む砥粒を含有する。セリウム酸化物を含む砥粒を用いることにより、銅の研磨速度を向上させることができる。砥粒は、一種又は複数種の粒子を含んでよい。セリウム酸化物以外の砥粒の構成材料としては、シリカ (SiO_2)、アルミナ、ジルコニア、チタニア、ゲルマニア、炭化ケイ素等の無機材料などが挙げられる。本実施形態に係る研磨液は、砥粒の構成材料等として、アルミナを含有しなくてよい。アルミナの含有量は、研磨液の全質量を基準として、0.1質量%以下、0.1質量%未満、0.01質量%以下、0.001質量%以下、又は、実質的に0質量%であってよい。

[0015] 砥粒におけるセリウム酸化物の含有量は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、砥粒全体（研磨液に含まれる砥粒全体、又は、砥粒を構成する一の粒子の全体）を基準として、90質量%以上、93質量%以上、95質量%以上、95質量%超、98質量%以上、99質量%以上、99.5質量%以上、又は、99.9質量%以上であってよい。砥粒は、実質的にセリウム酸

化物からなる態様（実質的に砥粒の100質量%がセリウム酸化物である態様）であってよい。

[0016] 砥粒の平均粒径D50又はD80は、下記の範囲であってよい。砥粒の平均粒径D50及びD80は、体積基準の累積分布の50%粒径及び80%粒径を意味し、例えばレーザー回折式粒度分布計により測定できる。砥粒の平均粒径は、自然沈降、粉碎処理、分散、ろ過等により調整可能であり、例えば、研磨液の構成成分を混合した後に粒径調整を施してよい。

[0017] 砥粒の平均粒径D50は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、10nm以上、50nm以上、70nm以上、100nm以上、150nm以上、150nm超、200nm以上、250nm以上、300nm以上、320nm以上、又は、340nm以上であってよい。砥粒の平均粒径D50は、研磨傷を抑制しやすい観点から、1000nm以下、800nm以下、600nm以下、500nm以下、450nm以下、400nm以下、又は、350nm以下であってよい。これらの観点から、砥粒の平均粒径D50は、10~1000nm、50~800nm、100~500nm、又は、200~400nmであってよい。

[0018] 砥粒の平均粒径D80は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、50nm以上、100nm以上、200nm以上、300nm以上、350nm以上、400nm以上、450nm以上、500nm以上、550nm以上、又は、600nm以上であってよい。砥粒の平均粒径D80は、研磨傷を抑制しやすい観点から、1200nm以下、1100nm以下、1000nm以下、900nm以下、800nm以下、750nm以下、700nm以下、又は、650nm以下であってよい。これらの観点から、砥粒の平均粒径D80は、50~1200nm、100~1000nm、300~800nm、又は、500~700nmであってよい。

[0019] 砥粒の含有量は、研磨液の全質量を基準として下記の範囲であってよい。砥粒の含有量は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、0.01質量%以上、0.05質量%以上、0.1質量%以上、0.3質量%以上、0.5質

量%以上、0.5質量%超、0.7質量%以上、0.8質量%以上、0.9質量%以上、又は、1質量%以上であってよい。砥粒の含有量は、研磨液の粘度の上昇、砥粒の凝集等を避けやすい観点から、10質量%以下、8質量%以下、5質量%以下、4質量%以下、3質量%以下、2質量%以下、1.5質量%以下、又は、1質量%以下であってよい。これらの観点から、砥粒の含有量は、0.01~10質量%、0.1~5質量%、0.5~2質量%、又は、0.5~1.5質量%であってよい。

[0020] 本実施形態に係る研磨液は、アンモニウム塩を含有する。アンモニウム塩は、酸成分とアンモニウムカチオンとの塩である。アンモニウム塩は、無機酸のアンモニウム塩、及び、有機酸のアンモニウム塩からなる群より選ばれる少なくとも一種を含んでよい。アンモニウム塩は、過酸化物とは異なるアンモニウム塩を含んでよく、過酸化物（過硫酸アンモニウム等）を含んでよい。

[0021] 無機酸のアンモニウム塩としては、硝酸アンモニウム、塩化アンモニウム、臭化アンモニウム等の1価の無機酸のアンモニウム塩；炭酸アンモニウム、炭酸水素アンモニウム、硫酸アンモニウム、過硫酸アンモニウム等の2価の無機酸のアンモニウム塩；リン酸アンモニウム、リン酸水素アンモニウム、リン酸二水素アンモニウム、ホウ酸アンモニウム等の3価の無機酸のアンモニウム塩などが挙げられる。アンモニウム塩は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、炭酸アンモニウムを含んでよく、過硫酸アンモニウムを含んでよい。

[0022] 有機酸のアンモニウム塩における有機酸としては、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、吉草酸、2-メチル酪酸、n-ヘキサン酸、3,3-ジメチル酪酸、2-エチル酪酸、4-メチルペンタン酸、n-ヘプタン酸、2-メチルヘキサン酸、n-オクタン酸、2-エチルヘキサン酸、安息香酸、グリコール酸、サリチル酸、グリセリン酸、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、3-メチルフタル酸、4-メチルフタル酸、3-アミノフタル酸、4-アミノフタル酸、3-ニトロフタル酸、4-ニトロフタル酸、グルタル酸、アジピン

酸、ピメリン酸、マレイン酸、フタル酸、イソフタル酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸、p-トールエンスルホン酸、p-フェノールスルホン酸、メチルスルホン酸、乳酸、イタコン酸、マレイン酸、キナルジン酸、アジピン酸、ピメリン酸等が挙げられる。アンモニウム塩は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、酢酸アンモニウムを含んでよい。

[0023] アンモニウム塩は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、無機酸のアンモニウム塩を含んでよく、2価の無機酸のアンモニウム塩を含んでよく、炭酸アンモニウム及び過硫酸アンモニウムからなる群より選ばれる少なくとも一種を含んでよい。アンモニウム塩は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、過酸化物とは異なるアンモニウム塩、及び、過酸化物を含んでよく、炭酸アンモニウム及び過硫酸アンモニウムを含んでよい。アンモニウム塩は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、塩化アンモニウム、炭酸アンモニウム、炭酸水素アンモニウム、硫酸アンモニウム、過硫酸アンモニウム、リン酸二水素アンモニウム、及び、酢酸アンモニウムからなる群より選ばれる少なくとも一種を含んでよい。

[0024] アンモニウム塩は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、下記分子量を有する化合物を含んでよい。分子量は、50以上、60以上、70以上、75以上、78以上、80以上、90以上、100以上、110以上、120以上、130以上、140以上、150以上、180以上、200以上、又は、220以上であってよい。分子量は、1000以下、1000未満、800以下、500以下、300以下、250以下、230以下、220以下、200以下、180以下、150以下、140以下、130以下、120以下、110以下、100以下、90以下、80以下、78以下、75以下、70以下、又は、60以下であってよい。これらの観点から、分子量は、50~1000、70~1000、80~1000、50~500、70~500、80~500、50~250、70~250、80~250、50~100、70~100、又は、80~100であってよい。

[0025] 過酸化物とは異なるアンモニウム塩の含有量、又は、炭酸アンモニウムの

含有量として、含有量A1は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、アンモニウム塩の全質量（研磨液に含まれるアンモニウム塩の全質量）を基準として下記の範囲であってよい。含有量A1は、0質量%超、1質量%以上、5質量%以上、10質量%以上、20質量%以上、30質量%以上、34質量%以上、35質量%以上、40質量%以上、41質量%以上、45質量%以上、50質量%以上、60質量%以上、70質量%以上、80質量%以上、90質量%以上、95質量%以上、又は、99質量%以上であってよい。研磨液に含まれるアンモニウム塩は、実質的に、過酸化物とは異なるアンモニウム塩、又は、炭酸アンモニウムからなる態様（実質的に、研磨液に含まれるアンモニウム塩の100質量%が、過酸化物とは異なるアンモニウム塩、又は、炭酸アンモニウムである態様）であってよい。含有量A1は、100質量%以下、100質量%未満、99質量%以下、95質量%以下、90質量%以下、80質量%以下、70質量%以下、60質量%以下、50質量%以下、45質量%以下、41質量%以下、40質量%以下、35質量%以下、34質量%以下、30質量%以下、20質量%以下、10質量%以下、又は、5質量%以下であってよい。これらの観点から、含有量A1は、0質量%超100質量%以下、30～100質量%、50～100質量%、又は、80～100質量%であってよい。

[0026] アンモニウム塩が過酸化物を含む場合、過酸化物（アンモニウム塩）の含有量、又は、過硫酸アンモニウムの含有量として、含有量A2は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、アンモニウム塩の全質量（研磨液に含まれるアンモニウム塩の全質量）を基準として下記の範囲であってよい。含有量A2は、0質量%超、1質量%以上、5質量%以上、10質量%以上、20質量%以上、30質量%以上、40質量%以上、50質量%以上、55質量%以上、59質量%以上、60質量%以上、65質量%以上、66質量%以上、70質量%以上、80質量%以上、90質量%以上、95質量%以上、99質量%以上、又は、実質的に100質量%（研磨液に含まれるアンモニウム塩が、実質的に、過酸化物又は過硫酸アンモニウムからなる態様）であつ

てよい。含有量A2は、100質量%以下、100質量%未満、99質量%以下、95質量%以下、90質量%以下、80質量%以下、70質量%以下、66質量%以下、65質量%以下、60質量%以下、又は、59質量%以下であってよい。これらの観点から、含有量A2は、0質量%超100質量%以下、50~100質量%、60~100質量%、0質量%超100質量%未満、50質量%以上100質量%未満、又は、60質量%以上100質量%未満であってよい。

[0027] アンモニウム塩の含有量（アンモニウム塩に該当する化合物の合計量。以下同様）、過酸化物とは異なるアンモニウム塩の含有量、又は、炭酸アンモニウムの含有量として、含有量B1は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、研磨液の全質量を基準として下記の範囲であってよい。含有量B1は、0質量%超、0.01質量%以上、0.02質量%以上、0.05質量%以上、0.1質量%以上、0.2質量%以上、0.3質量%以上、0.4質量%以上、0.45質量%以上、0.5質量%以上、0.5質量%超、0.6質量%以上、0.7質量%以上、0.8質量%以上、0.85質量%以上、0.9質量%以上、1質量%以上、1.1質量%以上、1.2質量%以上、1.3質量%以上、1.4質量%以上、1.5質量%以上、又は、1.6質量%以上であってよい。含有量B1は、10質量%以下、8質量%以下、5質量%以下、4質量%以下、3質量%以下、2質量%以下、1.8質量%以下、1.7質量%以下、1.6質量%以下、1.5質量%以下、1.4質量%以下、1.3質量%以下、1.2質量%以下、1.1質量%以下、1質量%以下、0.9質量%以下、0.85質量%以下、0.8質量%以下、0.7質量%以下、0.6質量%以下、0.5質量%以下、0.45質量%以下、0.4質量%以下、0.3質量%以下、0.2質量%以下、0.1質量%以下、0.05質量%以下、又は、0.02質量%以下であってよい。これらの観点から、含有量B1は、0質量%超10質量%以下、0質量%超5質量%以下、0質量%超2質量%以下、0質量%超1質量%以下、0.01~10質量%、0.01~5質量%、0.01~2質量%、0.01~1質量%

%、0.1～10質量%、0.1～5質量%、0.1～2質量%、0.1～1質量%、0.3～10質量%、0.3～5質量%、0.3～2質量%、又は、0.3～1質量%であってよい。

[0028] アンモニウム塩が過酸化物を含む場合、過酸化物（アンモニウム塩）の含有量、又は、過硫酸アンモニウムの含有量として、含有量B2は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、研磨液の全質量を基準として下記の範囲であってよい。含有量B2は、0質量%超、0.01質量%以上、0.05質量%以上、0.1質量%以上、0.2質量%以上、0.3質量%以上、0.4質量%以上、0.5質量%以上、0.5質量%超、0.6質量%以上、0.65質量%以上、0.7質量%以上、0.75質量%以上、又は、0.8質量%以上であってよい。含有量B2は、5質量%以下、4質量%以下、3質量%以下、2質量%以下、1.5質量%以下、1.2質量%以下、1質量%以下、0.9質量%以下、0.8質量%以下、0.75質量%以下、0.7質量%以下、0.65質量%以下、又は、0.6質量%以下であってよい。これらの観点から、含有量B2は、0質量%超5質量%以下、0.01～5質量%、0.1～5質量%、0.5～5質量%、0質量%超1質量%以下、0.01～1質量%、0.1～1質量%、又は、0.5～1質量%であってよい。

[0029] アンモニウム塩の含有量、過酸化物とは異なるアンモニウム塩の含有量、又は、炭酸アンモニウムの含有量として、含有量C1は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、砥粒100質量部に対して下記の範囲であってよい。含有量C1は、0質量部超、1質量部以上、2質量部以上、5質量部以上、10質量部以上、20質量部以上、30質量部以上、40質量部以上、45質量部以上、50質量部以上、60質量部以上、70質量部以上、80質量部以上、85質量部以上、90質量部以上、100質量部以上、110質量部以上、120質量部以上、130質量部以上、140質量部以上、150質量部以上、又は、160質量部以上であってよい。含有量C1は、1000質量部以下、800質量部以下、500質量部以下、400質量部以下、

300質量部以下、200質量部以下、180質量部以下、170質量部以下、160質量部以下、150質量部以下、140質量部以下、130質量部以下、120質量部以下、110質量部以下、100質量部以下、90質量部以下、85質量部以下、80質量部以下、70質量部以下、60質量部以下、50質量部以下、45質量部以下、40質量部以下、30質量部以下、20質量部以下、10質量部以下、5質量部以下、又は、2質量部以下であってよい。これらの観点から、含有量C1は、0質量部超1000質量部以下、0質量部超500質量部以下、0質量部超200質量部以下、0質量部超100質量部以下、1~1000質量部、1~500質量部、1~200質量部、1~100質量部、10~1000質量部、10~500質量部、10~200質量部、10~100質量部、30~1000質量部、30~500質量部、30~200質量部、又は、30~100質量部であってよい。

[0030] アンモニウム塩が過酸化物を含む場合、過酸化物（アンモニウム塩）の含有量、又は、過硫酸アンモニウムの含有量として、含有量C2は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、砥粒100質量部に対して下記の範囲であってよい。含有量C2は、0質量部超、1質量部以上、5質量部以上、10質量部以上、20質量部以上、30質量部以上、40質量部以上、50質量部以上、60質量部以上、65質量部以上、70質量部以上、75質量部以上、又は、80質量部以上であってよい。含有量C2は、500質量部以下、400質量部以下、300質量部以下、200質量部以下、150質量部以下、120質量部以下、100質量部以下、90質量部以下、80質量部以下、75質量部以下、70質量部以下、65質量部以下、又は、60質量部以下であってよい。これらの観点から、含有量C2は、0質量部超500質量部以下、1~500質量部、10~500質量部、50~500質量部、0質量部超100質量部以下、1~100質量部、10~100質量部、又は、50~100質量部であってよい。

[0031] (水)

本実施形態に係る研磨液は、水を含含有してよい。水は、研磨液から他の構成成分を除いた残部として含有されていればよい。水の含有量は、研磨液の全質量を基準として下記の範囲であってよい。水の含有量は、90質量%以上、91質量%以上、92質量%以上、93質量%以上、94質量%以上、94.5質量%以上、95質量%以上、95.5質量%以上、96質量%以上、97質量%以上、又は、98質量%以上であってよい。水の含有量は、100質量%未満、99質量%以下、98質量%以下、97質量%以下、96質量%以下、又は、95.5質量%以下であってよい。これらの観点から、水の含有量は、90質量%以上100質量%未満、90~99質量%、又は、95~99質量%であってよい。

[0032] (添加剤)

本実施形態に係る研磨液は、砥粒、アンモニウム塩、及び、水以外の成分を含含有してよい。このような成分としては、アンモニア、ヒドロキシ基を有するエーテル化合物、ヒドロキシ基を有しないエーテル化合物、酸成分、防食剤、塩基性水酸化物、過酸化物、有機溶媒、界面活性剤、消泡剤等が挙げられる。本実施形態に係る研磨液は、これらの成分の少なくとも一種を含含有しなくてもよい。

[0033] 本実施形態に係る研磨液は、アンモニアを含含有してよい。アンモニアが銅と錯体を形成し、銅の研磨速度が向上しやすいと推測される。

[0034] アンモニアの含有量は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、研磨液の全質量を基準として下記の範囲であってよい。アンモニアの含有量は、0質量%超、0.01質量%以上、0.03質量%以上、0.05質量%以上、0.08質量%以上、0.1質量%以上、0.12質量%以上、0.15質量%以上、0.2質量%以上、0.25質量%以上、又は、0.3質量%以上であってよい。アンモニアの含有量は、5質量%以下、4質量%以下、3質量%以下、2質量%以下、1.5質量%以下、1質量%以下、0.8質量%以下、0.6質量%以下、0.5質量%以下、0.4質量%以下、0.3質量%以下、0.2質量%以下、又は、0.15質量%以下であってよい。

これらの観点から、アンモニアの含有量は、0質量%超5質量%以下、0.01～5質量%、0.1～5質量%、0.2～5質量%、0質量%超2質量%以下、0.01～2質量%、0.1～2質量%、0.2～2質量%、0質量%超0.5質量%以下、0.01～0.5質量%、0.1～0.5質量%、又は、0.2～0.5質量%であってよい。

[0035] アンモニアの含有量は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、砥粒100質量部に対して下記の範囲であってよい。アンモニアの含有量は、0質量部超、1質量部以上、3質量部以上、5質量部以上、8質量部以上、10質量部以上、12質量部以上、15質量部以上、20質量部以上、25質量部以上、又は、30質量部以上であってよい。アンモニアの含有量は、500質量部以下、400質量部以下、300質量部以下、200質量部以下、150質量部以下、100質量部以下、80質量部以下、60質量部以下、50質量部以下、50質量部未満、40質量部以下、30質量部以下、25質量部以下、20質量部以下、又は、15質量部以下であってよい。これらの観点から、アンモニアの含有量は、0質量部超500質量部以下、1～500質量部、10～500質量部、20～500質量部、0質量部超200質量部以下、1～200質量部、10～200質量部、20～200質量部、0質量部超50質量部以下、1～50質量部、10～50質量部、又は、20～50質量部であってよい。

[0036] アンモニアの含有量は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、アンモニウム塩100質量部に対して下記の範囲であってよい。アンモニアの含有量は、0質量部超、1質量部以上、5質量部以上、10質量部以上、15質量部以上、20質量部以上、25質量部以上、30質量部以上、35質量部以上、36質量部以上、40質量部以上、50質量部以上、60質量部以上、80質量部以上、100質量部以上、150質量部以上、200質量部以上、300質量部以上、500質量部以上、1000質量部以上、又は、1500質量部以上であってよい。アンモニアの含有量は、2000質量部以下、1500質量部以下、1000質量部以下、500質量部以下、300質

量部以下、200質量部以下、150質量部以下、100質量部以下、80質量部以下、60質量部以下、50質量部以下、40質量部以下、36質量部以下、35質量部以下、30質量部以下、25質量部以下、又は、20質量部以下であってよい。これらの観点から、アンモニアの含有量は、0質量部超2000質量部以下、10~2000質量部、100~2000質量部、300~2000質量部、0質量部超1500質量部以下、10~1500質量部、100~1500質量部、300~1500質量部、又は、1~200質量部であってよい。

[0037] 本実施形態に係る研磨液は、ヒドロキシ基を有するエーテル化合物（以下、場合により「エーテル化合物A」という）を含有してよい。ヒドロキシ基を有するエーテル化合物は、少なくとも一つのヒドロキシ基及び少なくとも一つのエーテル基を有する化合物である。エーテル化合物Aにおける「エーテル基」は、ヒドロキシ基（水酸基）、カルボキシ基、カルボン酸塩基、エステル基、スルホ基及びリン酸基における「-O-」構造を包含しない。ヒドロキシ基は、カルボキシ基、スルホ基及びリン酸基に含まれるOH基を包含しない。

[0038] エーテル化合物Aは、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、ヒドロキシ基の数が下記の範囲である化合物を含んでよい。ヒドロキシ基の数は、1以上であり、2以上、3以上、4以上、5以上、6以上、8以上、9以上、10以上、11以上、又は、12以上であってよい。ヒドロキシ基の数は、20以下、15以下、12以下、11以下、10以下、9以下、8以下、6以下、5以下、4以下、3以下、又は、2以下であってよい。これらの観点から、ヒドロキシ基の数は、1~20、1~10、1~5、1~3、又は、1~2であってよい。エーテル化合物Aは、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、1つのヒドロキシ基を有する化合物を含んでよく、2つ以上のヒドロキシ基を有する化合物を含んでよく、1つのヒドロキシ基を有する化合物と、2つ以上のヒドロキシ基を有する化合物と、を含んでよい。

[0039] エーテル化合物Aは、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、エーテル基

の数が下記の範囲である化合物を含んでよい。エーテル基の数は、1以上であり、2以上、3以上、4以上、5以上、6以上、8以上、又は、9以上であってよい。エーテル基の数は、20以下、15以下、12以下、11以下、10以下、9以下、8以下、6以下、5以下、4以下、3以下、又は、2以下であってよい。これらの観点から、エーテル基の数は、1~20、1~10、1~5、1~3、又は、1~2であってよい。エーテル化合物Aは、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、1つのエーテル基を有する化合物を含んでよく、2つ以上のエーテル基を有する化合物を含んでよく、1つのエーテル基を有する化合物と、2つ以上のエーテル基を有する化合物と、を含んでよい。

[0040] エーテル化合物Aは、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、アルコキシアルコールを含んでよい。アルコキシアルコールとしては、2-メトキシエタノール、2-エトキシエタノール、2-(2-メトキシ)エトキシエタノール、2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール、2-プロポキシエタノール、2-ブトキシエタノール、3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール、2-(メトキシメトキシ)エタノール、2-イソプロポキシエタノール、2-ブトキシエタノール、2-イソペンチルオキシエタノール、1-プロポキシ-2-プロパノール、3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール、3-メトキシ-1-ブタノール、3-メトキシ-3-メチルブタノール、1-メトキシ-2-ブタノール、グリコールモノエーテル等が挙げられる。アルコキシアルコールは、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、炭素数が1~5、1~4、1~3、1~2、又は、2~3のアルコキシ基を有する化合物を含んでよい。アルコキシアルコールは、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、1-プロポキシ-2-プロパノールを含んでよく、3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノールを含んでよい。

[0041] エーテル化合物Aは、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、ポリエーテルを含んでよく、アルコキシアルコール及びポリエーテルを含んでよい。ポリエーテルとしては、ポリグリセリン、多糖類、ポリアルキレングリコール

、ポリオキシプロピレンポリグリセリルエーテル、ポリオキシエチレンポリグリセリルエーテル、1,4-ジ(2-ヒドロキシエトキシ)ベンゼン、2,2-ビス(4-ポリオキシエチレンオキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-ポリオキシプロピレンオキシフェニル)プロパン、エチレングリコールモノフェニルエーテル、ジエチレングリコールモノフェニルエーテル、ポリオキシアルキレンモノフェニルエーテル、プロピレングリコールモノフェニルエーテル、ポリオキシプロピレンモノメチルフェニルエーテル、ポリエチレングリコールモノメチルエーテル、ペンタエリスリトールポリオキシエチレンエーテル、エチレングリコールモノアリルエーテル、ポリオキシエチレンモノアリルエーテル、アルキルグルコシド等が挙げられる。ポリエーテルとしては、アルコキシアルコールとは異なる化合物を用いてよい。ポリエーテルは、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、ポリグリセリンを含んでよい。

[0042] エーテル化合物Aは、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、グリセリンの平均重合度が下記の範囲のポリグリセリンを含んでよい。平均重合度は、3以上、4以上、5以上、8以上、又は、10以上であってよい。平均重合度は、100以下、50以下、30以下、20以下、15以下、12以下、又は、10以下であってよい。これらの観点から、平均重合度は、3~100、5~50、8~20、5~15、又は、8~15であってよい。

[0043] エーテル化合物Aは、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、水酸基価が下記の範囲のポリグリセリンを含んでよい。水酸基価は、100以上、200以上、300以上、400以上、500以上、600以上、700以上、800以上、850以上、又は、870以上であってよい。水酸基価は、2000以下、1500以下、1200以下、1100以下、1000以下、950以下、930以下、又は、910以下であってよい。これらの観点から、水酸基価は、100~2000、300~1500、500~1200、又は、800~1000であってよい。

[0044] エーテル化合物Aは、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、1つのヒド

ロキシ基及び1つのエーテル基を有する化合物を含んでよい。エーテル化合物Aは、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、置換基としてヒドロキシ基を有するアルキル基と、無置換のアルキル基と、を結合するエーテル基を有する化合物を含んでよく、当該化合物は、1つのヒドロキシ基及び1つのエーテル基を有する化合物であってよい。

[0045] エーテル化合物Aは、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、下記分子量を有する化合物を含んでよい。分子量は、50以上、80以上、100以上、110以上、115以上、118以上、120以上、150以上、190以上、200以上、200超、300以上、500以上、700以上、又は、750以上であってよい。分子量は、3000以下、2000以下、1500以下、1200以下、1000以下、800以下、750以下、700以下、500以下、300以下、200以下、200未満、190以下、150以下、又は、120以下であってよい。これらの観点から、分子量は、50~3000、80~1000、100~500、100~200、又は、100以上200未満であってよい。エーテル化合物Aは、例えば、分子量200未満のアルコキシアルコールを含んでよい。

[0046] エーテル化合物Aが高分子である場合には、上述の分子量として重量平均分子量(Mw)を用いてよい。重量平均分子量は、例えば、ゲル浸透クロマトグラフィー(GPC: Gel Permeation Chromatography)を用いて、下記の条件で測定できる。

[条件]

試料：20 μ L

標準ポリエチレングリコール：ポリマー・ラボラトリー社製、標準ポリエチレングリコール(分子量：106、194、440、600、1470、4100、7100、10300、12600及び23000)

検出器：昭和電工株式会社製、RIモニター、商品名「Syodex-RISE-61」

ポンプ：株式会社日立製作所製、商品名「L-6000」

カラム：昭和電工株式会社製、商品名「GS-220HQ」及び「GS-620HQ」をこの順番で連結して使用

溶離液：0.4 mol/Lの塩化ナトリウム水溶液

測定温度：30℃

流速：1.00 mL/min

測定時間：45 min

[0047] アルコキシアルコールの含有量は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、エーテル化合物の全質量（研磨液に含まれるエーテル化合物の全質量）、又は、エーテル化合物Aの全質量（研磨液に含まれるエーテル化合物Aの全質量）を基準として下記の範囲であってよい。アルコキシアルコールの含有量は、0質量%超、5質量%以上、8質量%以上、10質量%以上、12質量%以上、15質量%以上、18質量%以上、20質量%以上、23質量%以上、24質量%以上、25質量%以上、30質量%以上、35質量%以上、40質量%以上、45質量%以上、50質量%以上、50質量%超、55質量%以上、60質量%以上、65質量%以上、70質量%以上、75質量%以上、80質量%以上、85質量%以上、90質量%以上、95質量%以上、99質量%以上、又は、実質的に100質量%（研磨液に含まれるエーテル化合物又はエーテル化合物Aが、実質的に、アルコキシアルコールからなる態様）であってよい。アルコキシアルコールの含有量は、100質量%以下、100質量%未満、95質量%以下、90質量%以下、85質量%以下、80質量%以下、75質量%以下、70質量%以下、65質量%以下、60質量%以下、55質量%以下、50質量%以下、50質量%未満、45質量%以下、40質量%以下、35質量%以下、30質量%以下、25質量%以下、又は、24質量%以下であってよい。これらの観点から、アルコキシアルコールの含有量は、0質量%超100質量%以下、5～100質量%、5～95質量%、5～50質量%、5～40質量%、20～100質量%、20～95質量%、20～50質量%、又は、20～40質量%であってよい。

[0048] ポリエーテルの含有量又はポリグリセリンの含有量として、含有量Dは、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、エーテル化合物の全質量（研磨液に含まれるエーテル化合物の全質量）、又は、エーテル化合物Aの全質量（研磨液に含まれるエーテル化合物Aの全質量）を基準として下記の範囲であってよい。含有量Dは、0質量%超、5質量%以上、10質量%以上、15質量%以上、20質量%以上、25質量%以上、30質量%以上、35質量%以上、40質量%以上、45質量%以上、50質量%以上、50質量%超、55質量%以上、60質量%以上、65質量%以上、70質量%以上、75質量%以上、又は、76質量%以上であってよい。含有量Dは、100質量%以下、100質量%未満、95質量%以下、92質量%以下、90質量%以下、88質量%以下、85質量%以下、82質量%以下、80質量%以下、77質量%以下、又は、76質量%以下であってよい。これらの観点から、含有量Dは、0質量%超100質量%以下、0質量%超95質量%以下、5～95質量%、50～95質量%、60～95質量%、0質量%超80質量%以下、5～80質量%、50～80質量%、又は、60～80質量%であってよい。

[0049] エーテル化合物Aの含有量は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、研磨液の全質量を基準として下記の範囲であってよい。エーテル化合物Aの含有量は、0質量%超、0.01質量%以上、0.03質量%以上、0.05質量%以上、0.08質量%以上、0.1質量%以上、0.3質量%以上、0.5質量%以上、0.8質量%以上、1質量%以上、1質量%超、1.1質量%以上、1.2質量%以上、1.3質量%以上、1.31質量%以上、1.32質量%以上、又は、1.33質量%以上であってよい。エーテル化合物Aの含有量は、10質量%以下、8質量%以下、5質量%以下、3質量%以下、2質量%以下、1.8質量%以下、1.7質量%以下、1.6質量%以下、1.5質量%以下、1.4質量%以下、1.35質量%以下、1.33質量%以下、1.32質量%以下、又は、1.31質量%以下であってよい。これらの観点から、エーテル化合物Aの含有量は、0質量%超10質

量%以下、0.1~10質量%、0.5~10質量%、1~10質量%、0質量%超5質量%以下、0.1~5質量%、0.5~5質量%、1~5質量%、0質量%超3質量%以下、0.1~3質量%、0.5~3質量%、又は、1~3質量%であってよい。

[0050] アルコキシアルコールの含有量は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、研磨液の全質量を基準として下記の範囲であってよい。アルコキシアルコールの含有量は、0質量%超、0.01質量%以上、0.03質量%以上、0.05質量%以上、0.08質量%以上、0.1質量%以上、0.15質量%以上、0.2質量%以上、0.25質量%以上、0.3質量%以上、0.31質量%以上、0.33質量%以上、0.35質量%以上、0.4質量%以上、0.45質量%以上、0.5質量%以上、0.55質量%以上、0.6質量%以上、0.65質量%以上、0.7質量%以上、0.8質量%以上、又は、1質量%以上であってよい。アルコキシアルコールの含有量は、5質量%以下、3質量%以下、1質量%以下、0.8質量%以下、0.7質量%以下、0.65質量%以下、0.6質量%以下、0.55質量%以下、0.5質量%以下、0.45質量%以下、0.4質量%以下、0.35質量%以下、0.33質量%以下、又は、0.31質量%以下であってよい。これらの観点から、アルコキシアルコールの含有量は、0質量%超5質量%以下、0.01~5質量%、0.1~5質量%、0.2~5質量%、0質量%超1質量%以下、0.01~1質量%、0.1~1質量%、0.2~1質量%、0質量%超0.8質量%以下、0.01~0.8質量%、0.1~0.8質量%、0.2~0.8質量%、0質量%超0.5質量%以下、0.01~0.5質量%、0.1~0.5質量%、又は、0.2~0.5質量%であってよい。

[0051] ポリエーテルの含有量又はポリグリセリンの含有量として、含有量Eは、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、研磨液の全質量を基準として下記の範囲であってよい。含有量Eは、0質量%超、0.01質量%以上、0.05質量%以上、0.1質量%以上、0.3質量%以上、0.5質量%以上、

0.6質量%以上、0.8質量%以上、0.9質量%以上、又は、1質量%以上であってよい。含有量Eは、10質量%以下、8質量%以下、7質量%以下、6質量%以下、5質量%以下、4質量%以下、3質量%以下、2質量%以下、1.5質量%以下、又は、1質量%以下であってよい。これらの観点から、含有量Eは、0質量%超10質量%以下、0.01~10質量%、0.1~5質量%、0.5~3質量%、又は、0.5~2質量%であってよい。

[0052] エーテル化合物Aの含有量は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、砥粒100質量部に対して下記の範囲であってよい。エーテル化合物Aの含有量は、0質量部超、1質量部以上、3質量部以上、5質量部以上、8質量部以上、10質量部以上、30質量部以上、50質量部以上、80質量部以上、100質量部以上、100質量部超、110質量部以上、120質量部以上、130質量部以上、131質量部以上、132質量部以上、又は、133質量部以上であってよい。エーテル化合物Aの含有量は、1000質量部以下、800質量部以下、500質量部以下、300質量部以下、200質量部以下、180質量部以下、170質量部以下、160質量部以下、150質量部以下、140質量部以下、135質量部以下、133質量部以下、132質量部以下、又は、131質量部以下であってよい。これらの観点から、エーテル化合物Aの含有量は、0質量部超1000質量部以下、10~1000質量部、50~1000質量部、100~1000質量部、0質量部超500質量部以下、10~500質量部、50~500質量部、100~500質量部、0質量部超300質量部以下、10~300質量部、50~300質量部、又は、100~300質量部であってよい。

[0053] アルコキシアルコールの含有量は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、砥粒100質量部に対して下記の範囲であってよい。アルコキシアルコールの含有量は、0質量部超、1質量部以上、3質量部以上、5質量部以上、8質量部以上、10質量部以上、15質量部以上、20質量部以上、25質量部以上、30質量部以上、31質量部以上、33質量部以上、35質量部

以上、40質量部以上、45質量部以上、50質量部以上、55質量部以上、60質量部以上、65質量部以上、70質量部以上、80質量部以上、又は、100質量部以上であってよい。アルコキシアアルコールの含有量は、500質量部以下、300質量部以下、100質量部以下、80質量部以下、70質量部以下、65質量部以下、60質量部以下、55質量部以下、50質量部以下、45質量部以下、40質量部以下、35質量部以下、33質量部以下、又は、31質量部以下であってよい。これらの観点から、アルコキシアアルコールの含有量は、0質量部超500質量部以下、1～500質量部、10～500質量部、20～500質量部、0質量部超100質量部以下、1～100質量部、10～100質量部、20～100質量部、0質量部超80質量部以下、1～80質量部、10～80質量部、20～80質量部、0質量部超50質量部以下、1～50質量部、10～50質量部、又は、20～50質量部であってよい。

[0054] ポリエーテルの含有量又はポリグリセリンの含有量として、含有量Fは、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、砥粒100質量部に対して下記の範囲であってよい。含有量Fは、0質量部超、1質量部以上、5質量部以上、10質量部以上、30質量部以上、50質量部以上、60質量部以上、80質量部以上、90質量部以上、又は、100質量部以上であってよい。含有量Fは、1000質量部以下、800質量部以下、700質量部以下、600質量部以下、500質量部以下、400質量部以下、300質量部以下、200質量部以下、150質量部以下、又は、100質量部以下であってよい。これらの観点から、含有量Fは、0質量部超1000質量部以下、1～1000質量部、10～500質量部、50～300質量部、又は、50～200質量部であってよい。

[0055] エーテル化合物Aの含有量は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、アンモニウム塩100質量部に対して下記の範囲であってよい。エーテル化合物Aの含有量は、0質量部超、10質量部以上、30質量部以上、50質量部以上、70質量部以上、80質量部以上、100質量部以上、110質量

部以上、120質量部以上、130質量部以上、140質量部以上、150質量部以上、155質量部以上、160質量部以上、180質量部以上、200質量部以上、250質量部以上、300質量部以上、315質量部以上、320質量部以上、350質量部以上、400質量部以上、500質量部以上、600質量部以上、700質量部以上、800質量部以上、1000質量部以上、2000質量部以上、又は、5000質量部以上であってよい。エーテル化合物Aの含有量は、8000質量部以下、5000質量部以下、2000質量部以下、1000質量部以下、800質量部以下、700質量部以下、600質量部以下、500質量部以下、400質量部以下、350質量部以下、320質量部以下、315質量部以下、300質量部以下、250質量部以下、200質量部以下、180質量部以下、160質量部以下、155質量部以下、150質量部以下、140質量部以下、130質量部以下、120質量部以下、110質量部以下、100質量部以下、又は、80質量部以下であってよい。これらの観点から、エーテル化合物Aの含有量は、0質量部超8000質量部以下、10~8000質量部、100~8000質量部、0質量部超1000質量部以下、10~1000質量部、100~1000質量部、0質量部超200質量部以下、10~200質量部、又は、100~200質量部であってよい。

[0056] アルコキシアルコールの含有量は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、アンモニウム塩100質量部に対して下記の範囲であってよい。アルコキシアルコールの含有量は、0質量部超、1質量部以上、5質量部以上、10質量部以上、15質量部以上、20質量部以上、25質量部以上、30質量部以上、35質量部以上、38質量部以上、40質量部以上、45質量部以上、50質量部以上、55質量部以上、60質量部以上、65質量部以上、70質量部以上、75質量部以上、80質量部以上、90質量部以上、100質量部以上、150質量部以上、200質量部以上、300質量部以上、500質量部以上、又は、1000質量部以上であってよい。アルコキシアルコールの含有量は、2000質量部以下、1000質量部以下、500質

量部以下、300質量部以下、200質量部以下、150質量部以下、100質量部以下、90質量部以下、80質量部以下、75質量部以下、70質量部以下、65質量部以下、60質量部以下、55質量部以下、50質量部以下、45質量部以下、40質量部以下、38質量部以下、35質量部以下、30質量部以下、25質量部以下、又は、20質量部以下であってよい。これらの観点から、アルコキシアルコールの含有量は、0質量部超2000質量部以下、0質量部超1000質量部以下、0質量部超200質量部以下、1~2000質量部、1~1000質量部、1~200質量部、50~2000質量部、50~1000質量部、又は、50~200質量部であってよい。

[0057] ポリエーテルの含有量又はポリグリセリンの含有量として、含有量Gは、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、アンモニウム塩100質量部に対して下記の範囲であってよい。含有量Gは、0質量部超、10質量部以上、30質量部以上、50質量部以上、60質量部以上、80質量部以上、90質量部以上、100質量部以上、110質量部以上、115質量部以上、120質量部以上、150質量部以上、180質量部以上、200質量部以上、230質量部以上、250質量部以上、300質量部以上、400質量部以上、500質量部以上、600質量部以上、800質量部以上、1000質量部以上、2000質量部以上、又は、5000質量部以上であってよい。含有量Gは、8000質量部以下、5000質量部以下、2000質量部以下、1000質量部以下、800質量部以下、600質量部以下、500質量部以下、400質量部以下、300質量部以下、250質量部以下、230質量部以下、200質量部以下、180質量部以下、150質量部以下、120質量部以下、115質量部以下、110質量部以下、100質量部以下、90質量部以下、80質量部以下、又は、60質量部以下であってよい。これらの観点から、含有量Gは、0質量部超8000質量部以下、0質量部超1000質量部以下、0質量部超300質量部以下、10~8000質量部、10~1000質量部、10~300質量部、100~8000質量

部、100～1000質量部、又は、100～300質量部であってよい。

[0058] アルコキシアアルコールの含有量は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、ポリエーテル100質量部又はポリグリセリン100質量部に対して下記の範囲であってよい。アルコキシアアルコールの含有量は、0質量部超、1質量部以上、3質量部以上、5質量部以上、8質量部以上、10質量部以上、15質量部以上、20質量部以上、25質量部以上、30質量部以上、31質量部以上、又は、33質量部以上であってよい。アルコキシアアルコールの含有量は、1000質量部以下、800質量部以下、700質量部以下、600質量部以下、500質量部以下、400質量部以下、300質量部以下、200質量部以下、150質量部以下、120質量部以下、100質量部以下、80質量部以下、70質量部以下、60質量部以下、50質量部以下、40質量部以下、35質量部以下、33質量部以下、又は、31質量部以下であってよい。これらの観点から、アルコキシアアルコールの含有量は、0質量部超1000質量部以下、1～1000質量部、10～1000質量部、0質量部超200質量部以下、1～200質量部、10～200質量部、0質量部超100質量部以下、1～100質量部、10～100質量部、0質量部超50質量部以下、1～50質量部、又は、10～50質量部であってよい。

[0059] 本実施形態に係る研磨液は、エーテル化合物Aとして、キサンタンガムを含有しなくてよい。キサンタンガムの含有量は、研磨液の全質量を基準として、0.5質量%以下、0.5質量%未満、0.1質量%以下、0.01質量%以下、又は、実質的に0質量%であってよい。

[0060] 本実施形態に係る研磨液は、酸成分（アンモニウム塩に該当する化合物を除く）を含有してよい。酸成分が銅と錯体を形成すること、酸成分が銅を溶解すること等により、銅の研磨速度が向上しやすいと推測される。本実施形態に係る研磨液は、酸成分として、有機酸成分を含有してよく、無機酸成分を含有してよい。

[0061] 有機酸成分としては、有機酸（アミノ酸を除く）、有機酸エステル、有機

酸塩、アミノ酸、アミノ酸エステル、アミノ酸塩等が挙げられる。有機酸としては、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、吉草酸、2-メチル酪酸、n-ヘキサン酸、3,3-ジメチル酪酸、2-エチル酪酸、4-メチルペンタン酸、n-ヘプタン酸、2-メチルヘキサン酸、n-オクタン酸、2-エチルヘキサン酸、安息香酸、グリコール酸、サリチル酸、グリセリン酸、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、3-メチルフタル酸、4-メチルフタル酸、3-アミノフタル酸、4-アミノフタル酸、3-ニトロフタル酸、4-ニトロフタル酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、マレイン酸、フタル酸、イソフタル酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸、p-トルエンスルホン酸、p-フェノールスルホン酸、メチルスルホン酸、乳酸、イタコン酸、マレイン酸、キナルジン酸、アジピン酸、ピメリン酸等が挙げられる。有機酸エステルとしては、上述の有機酸のエステル等が挙げられる。有機酸塩としては、上述の有機酸のアルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩、ハロゲン化物等が挙げられる。アミノ酸としては、アラニン、アルギニン、アスパラギン、アスパラギン酸、システイン、グルタミン、グルタミン酸、グリシン、ヒスチジン、イソロイシン、ロイシン、リシン、メチオニン、フェニルアラニン、プロリン、セリン、トレオニン、トリプトファン、チロシン、バリン等が挙げられる。アミノ酸エステルとしては、上述のアミノ酸のエステル等が挙げられる。アミノ酸塩としては、上述の有機酸のアルカリ金属塩等が挙げられる。有機酸成分は、銅の研磨速度が更に向上しやすい観点から、アミノ酸とは異なる有機酸、及び、アミノ酸からなる群より選ばれる少なくとも一種を含んでよく、リンゴ酸及びグリシンからなる群より選ばれる少なくとも一種を含んでよい。

[0062] 無機酸成分としては、無機酸、無機酸の金属塩（アルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩等）などが挙げられる。無機酸としては、塩酸、硫酸、硝酸、クロム酸等が挙げられる。

[0063] アミノ酸とは異なる有機酸の含有量は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、研磨液の全質量を基準として下記の範囲であってよい。アミノ酸とは

異なる有機酸の含有量は、0質量%超、0.001質量%以上、0.003質量%以上、0.005質量%以上、0.008質量%以上、又は、0.01質量%以上であってよい。アミノ酸とは異なる有機酸の含有量は、1質量%以下、0.5質量%以下、0.1質量%以下、0.08質量%以下、0.05質量%以下、0.03質量%以下、0.02質量%以下、又は、0.01質量%以下であってよい。これらの観点から、アミノ酸とは異なる有機酸の含有量は、0質量%超1質量%以下、0.001~1質量%、0.001~0.1質量%、0.005~0.1質量%、又は、0.001~0.05質量%であってよい。

[0064] 酸成分の含有量又は有機酸成分の含有量として、含有量Hは、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、研磨液の全質量を基準として下記の範囲であってよい。含有量Hは、0質量%超、0.01質量%以上、0.05質量%以上、0.1質量%以上、0.2質量%以上、0.3質量%以上、0.4質量%以上、又は、0.41質量%以上であってよい。含有量Hは、2質量%以下、1.5質量%以下、1質量%以下、0.8質量%以下、0.6質量%以下、0.5質量%以下、0.45質量%以下、0.41質量%以下、又は、0.4質量%以下であってよい。これらの観点から、含有量Hは、0質量%超2質量%以下、0.01~2質量%、0.1~2質量%、0.01~1質量%、又は、0.1~1質量%であってよい。

[0065] 本実施形態に係る研磨液は、金属材料に対する防食作用を有する化合物として、防食剤（金属材料の防食剤）を含有してよい。防食剤は、金属材料に対して保護膜を形成することで、金属材料のエッチングを抑制して被研磨面の荒れを低減しやすい。

[0066] 防食剤は、トリアゾール化合物、ピリジン化合物、ピラゾール化合物、ピリミジン化合物、イミダゾール化合物、グアニジン化合物、チアゾール化合物、テトラゾール化合物、トリアジン化合物及びヘキサメチレンテトラミンからなる群より選ばれる少なくとも一種を含んでよい。「化合物」とは、その骨格を有する化合物の総称であり、例えば「トリアゾール化合物」とは、

トリアゾール骨格を有する化合物を意味する。防食剤は、好適な防食作用を得やすい観点から、トリアゾール化合物、ピリジン化合物、イミダゾール化合物、テトラゾール化合物、トリアジン化合物及びヘキサメチレンテトラミンからなる群より選ばれる少なくとも一種を含んでよく、トリアゾール化合物を含んでよく、ベンゾトリアゾール化合物を含んでよい。

[0067] トリアゾール化合物としては、1, 2, 3-トリアゾール、1, 2, 4-トリアゾール、3-アミノ-1H-1, 2, 4-トリアゾール、ベンゾトリアゾール、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール、1-ジヒドロキシプロピルベンゾトリアゾール、2, 3-ジカルボキシプロピルベンゾトリアゾール、4-ヒドロキシベンゾトリアゾール、4-カルボキシ-1H-ベンゾトリアゾール、4-カルボキシ-1H-ベンゾトリアゾールメチルエステル（1H-ベンゾトリアゾール-4-カルボン酸メチル）、4-カルボキシ-1H-ベンゾトリアゾールブチルエステル（1H-ベンゾトリアゾール-4-カルボン酸ブチル）、4-カルボキシ-1H-ベンゾトリアゾールオクチルエステル（1H-ベンゾトリアゾール-4-カルボン酸オクチル）、5-ヘキシルベンゾトリアゾール、[1, 2, 3-ベンゾトリアゾリル-1-メチル] [1, 2, 4-トリアゾリル-1-メチル] [2-エチルヘキシル] アミン、トリルトリアゾール、ナフトトリアゾール、ビス[(1-ベンゾトリアゾリル)メチル] ホスホン酸、3H-1, 2, 3-トリアゾロ [4, 5-b] ピリジン-3-オール、1H-1, 2, 3-トリアゾロ [4, 5-b] ピリジン、1-アセチル-1H-1, 2, 3-トリアゾロ [4, 5-b] ピリジン、1, 2, 4-トリアゾロ [1, 5-a] ピリミジン、2-メチル-5, 7-ジフェニル-[1, 2, 4] トリアゾロ [1, 5-a] ピリミジン、2-メチルサルファニル-5, 7-ジフェニル-[1, 2, 4] トリアゾロ [1, 5-a] ピリミジン、2-メチルサルファニル-5, 7-ジフェニル-4, 7-ジヒドロ-[1, 2, 4] トリアゾロ [1, 5-a] ピリミジン等が挙げられる。一分子中にトリアゾール骨格と、それ以外の骨格とを有する化合物は、トリアゾール化合物に分類するものとする。本実施形態に係る研

磨液は、好適な防食作用を得やすい観点から、ヒドロキシ基を有するトリアゾール化合物を含有してよく、1-ヒドロキシベンゾトリアゾールを含有してよい。

[0068] 防食剤の含有量、トリアゾール化合物の含有量、又は、ベンゾトリアゾール化合物の含有量として、含有量Iは、好適な防食作用を得やすい観点から、研磨液の全質量を基準として下記の範囲であってよい。含有量Iは、0質量%超、0.001質量%以上、0.003質量%以上、0.005質量%以上、0.008質量%以上、0.01質量%以上、0.02質量%以上、0.025質量%以上、又は、0.03質量%以上であってよい。含有量Iは、2質量%以下、1.5質量%以下、1質量%以下、0.5質量%以下、0.3質量%以下、0.1質量%以下、0.08質量%以下、0.05質量%以下、0.04質量%以下、0.03質量%以下、0.025質量%以下、0.02質量%以下、0.01質量%以下、又は、0.008質量%以下であってよい。これらの観点から、含有量Iは、0質量%超2質量%以下、0.001~2質量%、0.005~2質量%、0.01~2質量%、0質量%超1質量%以下、0.001~1質量%、0.005~1質量%、0.01~1質量%、0質量%超0.1質量%以下、0.001~0.1質量%、0.005~0.1質量%、又は、0.01~0.1質量%であってよい。

[0069] 本実施形態に係る研磨液は、塩基性水酸化物を含有してよい。塩基性水酸化物を用いることにより、銅の研磨速度が向上しやすい。塩基性水酸化物としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ金属水酸化物；アルカリ土類金属水酸化物；テトラメチルアンモニウムヒドロキシド（TMAH）などが挙げられる。

[0070] 塩基性水酸化物の含有量は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、研磨液の全質量を基準として下記の範囲であってよい。塩基性水酸化物の含有量は、0質量%超、0.01質量%以上、0.05質量%以上、0.1質量%以上、0.15質量%以上、0.2質量%以上、0.25質量%以上、0.

3質量%以上、0.35質量%以上、0.36質量%以上、0.4質量%以上、0.45質量%以上、又は、0.48質量%以上であってよい。塩基性水酸化物の含有量は、5質量%以下、4質量%以下、3質量%以下、2質量%以下、1質量%以下、0.8質量%以下、0.6質量%以下、0.5質量%以下、0.48質量%以下、0.45質量%以下、0.4質量%以下、0.36質量%以下、0.35質量%以下、0.3質量%以下、又は、0.25質量%以下であってよい。これらの観点から、塩基性水酸化物の含有量は、0質量%超5質量%以下、0.01~5質量%、0.1~5質量%、0質量%超1質量%以下、0.01~1質量%、又は、0.1~1質量%であってよい。

[0071] 本実施形態に係る研磨液は、上述のアンモニウム塩に該当しない過酸化物を含有してよく、当該過酸化物を含有しなくてよい。過酸化物としては、過硫酸カリウム、過酸化水素、硝酸第二鉄、硫酸鉄、オゾン、次亜塩素酸、次亜塩素酸塩、過ヨウ素酸カリウム、過酢酸等が挙げられる。本実施形態に係る研磨液は、過酸化水素を含有しなくてよい。過酸化物の含有量又は過酸化水素の含有量は、研磨液の全質量を基準として、0.1質量%以下、0.1質量%未満、0.01質量%以下、0.001質量%以下、又は、実質的に0質量%であってよい。

[0072] 本実施形態に係る研磨液は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、有機溶媒（エーテル化合物Aに該当しない有機溶媒）を含有してよい。有機溶媒としては、アルコール（モノアルコール及びポリオール）、炭酸エステル、ラクトン等が挙げられる。モノアルコールとしては、メタノール、エタノール、プロパノール（例えば2-プロパノール）、ブタノール、ペンタノール、オクタノール等が挙げられる。ポリオールとしては、メチレングリコール、エチレングリコール、プロピレングリコール、ブチレングリコール（例えば1,3-ブタンジオール）、ヘキシレングリコール等のジオール；グリセリンなどが挙げられる。炭酸エステルとしては、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、メ

チルエチルカーボネート等が挙げられる。ラクトンとしては、プロピオラクトン、ブチロラクトン等が挙げられる。有機溶媒は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、アルコールを含んでよく、モノアルコールを含んでよく、プロパノールを含んでよく、ポリオールを含んでよく、メチレングリコール、エチレングリコール、プロピレングリコール、ブチレングリコール、及び、ヘキシレングリコールからなる群より選ばれる少なくとも一種を含んでよい。

[0073] 有機溶媒の含有量は、銅の研磨速度が向上しやすい観点から、研磨液の全質量を基準として下記の範囲であってよい。有機溶媒の含有量は、0質量%超、0.1質量%以上、0.3質量%以上、0.5質量%以上、0.6質量%以上、0.7質量%以上、0.8質量%以上、1質量%以上、1.2質量%以上、又は、1.3質量%以上であってよい。有機溶媒の含有量は、20質量%以下、15質量%以下、10質量%以下、8質量%以下、5質量%以下、4質量%以下、3質量%以下、2質量%以下、又は、1.5質量%以下であってよい。これらの観点から、有機溶媒の含有量は、0質量%超20質量%以下、0.1~20質量%、1~20質量%、0質量%超5質量%以下、0.1~5質量%、又は、1~5質量%であってよい。

[0074] 本実施形態に係る研磨液は、ジヒドロキシエチルグリシン、アミノポリカルボン酸、及び、アミノポリカルボン酸の非金属塩を含有しなくてよい。ジヒドロキシエチルグリシン、アミノポリカルボン酸、及び、アミノポリカルボン酸の非金属塩の含有量（合計量）は、研磨液の全質量を基準として、0.05質量%以下、0.05質量%未満、0.01質量%以下、0.001質量%以下、又は、実質的に0質量%であってよい。

[0075] 本実施形態に係る研磨液は、不飽和カルボン酸の単量体単位を有する化合物を含有しなくてよく、ポリカルボン酸系高分子分散剤を含有しなくてよい。不飽和カルボン酸の単量体単位を有する化合物の含有量、又は、ポリカルボン酸系高分子分散剤の含有量は、研磨液の全質量を基準として、0.0005質量%以下、0.0005質量%未満、0.0001質量%以下、0.

0.0001質量%以下、又は、実質的に0質量%であってよい。

[0076] (pH)

本実施形態に係る研磨液のpHは、銅の研磨速度を向上させる観点から、9.00以上である。本実施形態に係る研磨液のpHは、銅の研磨速度を向上させつつ当該研磨速度を調整する観点から、下記の範囲であってよい。研磨液のpHは、9.10以上、9.15以上、9.20以上、9.25以上、9.30以上、9.35以上、9.40以上、9.45以上、9.50以上、9.55以上、9.60以上、9.65以上、9.70以上、9.75以上、9.80以上、9.85以上、9.90以上、9.95以上、10.00以上、10.00超、10.05以上、10.10以上、10.20以上、10.30以上、10.50以上、又は、10.80以上であってよい。研磨液のpHは、13.00以下、12.50以下、12.00以下、11.50以下、11.00以下、10.50以下、10.10以下、10.05以下、10.00以下、9.95以下、9.90以下、9.85以下、9.80以下、9.75以下、9.70以下、9.65以下、9.60以下、9.55以下、9.50以下、9.45以下、9.40以下、9.35以下、9.30以下、9.25以下、9.20以下、又は、9.15以下であってよい。これらの観点から、研磨液のpHは、9.00~13.00、9.00~12.00、9.00~11.00、9.00~10.00、9.30~13.00、9.30~12.00、9.30~11.00、9.30~10.00、9.50~13.00、9.50~12.00、9.50~11.00、又は、9.50~10.00であってよい。研磨液のpHは、上述のアンモニウム塩、アンモニア、酸成分、塩基性水酸化物等により調整できる。

[0077] 本実施形態に係る研磨液のpHは、pHメータ（例えば、東亜ディーケーケー株式会社製の型番：PHL-40）で測定できる。例えば、フタル酸塩pH緩衝液（pH：4.01）及び中性リン酸塩pH緩衝液（pH：6.86）を標準緩衝液として用いてpHメータを2点校正した後、pHメータの

電極を研磨液に入れ、2分以上経過して安定した後の値を測定する。このとき、標準緩衝液及び研磨液の液温は共に25℃とする。

[0078] (保存態様)

本実施形態に係る研磨液は、研磨液用貯蔵液として、水の量を使用時よりも減じて保存されてよい。研磨液用貯蔵液は、研磨液を得るための貯蔵液であり、使用前又は使用時に研磨液用貯蔵液を水で希釈することにより研磨液が得られる。希釈倍率は、例えば1.5倍以上である。

[0079] 本実施形態に係る研磨液は、少なくとも砥粒とアンモニウム塩とを含む一液式研磨液として保存してよく、スラリー（第一の液）と添加液（第二の液）とを有する複数液式研磨液として保存してもよい。複数液式研磨液では、スラリーと添加液とを混合して研磨液となるように研磨液の構成成分がスラリーと添加液とに分けられる。スラリーは、例えば、少なくとも砥粒及び水を含む。添加液は、例えば、少なくともアンモニウム塩及び水を含む。砥粒、アンモニウム塩、及び、水以外の成分は、スラリー及び添加液のうち添加液に含まれてよい。研磨液の構成成分は、三液以上に分けて保存してよい。複数液式研磨液においては、研磨直前又は研磨時にスラリー及び添加液が混合されて研磨液が調製されてよい。複数液式研磨液におけるスラリーと添加液とをそれぞれ研磨定盤上へ供給し、研磨定盤上においてスラリー及び添加液が混合されて研磨液が調製されてもよい。

[0080] <研磨方法>

本実施形態に係る研磨方法は、本実施形態に係る研磨液を用いて、銅を含有する被研磨部材を研磨する研磨工程を備える。研磨工程では、被研磨部材の被研磨面を研磨することが可能であり、銅が存在する被研磨面を研磨できる。研磨工程では、被研磨部材における銅の少なくとも一部を研磨して除去することができる。被研磨部材は、樹脂及び金属材料（例えば銅）を含有してよい。研磨工程では、樹脂及び金属材料が存在する被研磨面を研磨できる。研磨工程で用いられる研磨液は、上述の一液式研磨液であってよく、上述の研磨液用貯蔵液を水で希釈することにより得られる研磨液であってよく、

上述の複数液式研磨液におけるスラリー及び添加液を混合することにより得られる研磨液であってよい。被研磨部材は、特に限定されず、ウエハ（例えば半導体ウエハ）であってよく、チップ（例えば半導体チップ）であってよい。被研磨部材は、配線板であってよく、回路基板であってよい。

[0081] <製造方法等>

本実施形態に係る部品の製造方法は、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材（基体）を用いて部品を得る部品作製工程を備える。本実施形態に係る部品は、本実施形態に係る部品の製造方法により得られる部品である。本実施形態に係る部品は、特に限定されないが、電子部品（例えば、半導体パッケージ等の半導体部品）であってよく、ウエハ（例えば半導体ウエハ）であってよく、チップ（例えば半導体チップ）であってよい。本実施形態に係る部品の製造方法の一態様として、本実施形態に係る電子部品の製造方法では、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材を用いて電子部品を得る。本実施形態に係る部品の製造方法の一態様として、本実施形態に係る半導体部品の製造方法では、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材を用いて半導体部品（例えば半導体パッケージ）を得る。本実施形態に係る部品の製造方法は、部品作製工程の前に、本実施形態に係る研磨方法により被研磨部材を研磨する研磨工程を備えてよい。

[0082] 本実施形態に係る部品の製造方法は、部品作製工程の一態様として、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材（基体）を個片化する個片化工程を備えてよい。個片化工程は、例えば、本実施形態に係る研磨方法により研磨されたウエハ（例えば半導体ウエハ）をダイシングしてチップ（例えば半導体チップ）を得る工程であってよい。本実施形態に係る部品の製造方法の一態様として、本実施形態に係る電子部品の製造方法は、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材を個片化することにより電子部品（例えば半導体部品）を得る工程を備えてよい。本実施形態に係る部品の製造方法の一態様として、本実施形態に係る半導体部品の製造方法は、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材を個片化することによ

り半導体部品（例えば半導体パッケージ）を得る工程を備えてよい。

[0083] 本実施形態に係る部品の製造方法は、部品作製工程の一態様として、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材（基体）と他の被接続体とを接続（例えば電氣的に接続）する接続工程を備えてよい。本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材に接続される被接続体は、特に限定されず、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材であってよく、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材とは異なる被接続体であってよい。接続工程では、被研磨部材と被接続体とを直接接続（被研磨部材と被接続体とが接触した状態で接続）してよく、他の部材（導電部材等）を介して被研磨部材と被接続体とを接続してよい。接続工程は、個片化工程の前、個片化工程の後、又は、個片化工程の前後に行うことができる。

[0084] 接続工程は、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材の被研磨面と、被接続体と、を接続する工程であってよく、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材の接続面と、被接続体の接続面と、を接続する工程であってよい。被研磨部材の接続面は、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨面であってよい。接続工程により、被研磨部材及び被接続体を備える接続体を得ることができる。接続工程では、被研磨部材の接続面が金属部を有する場合、金属部に被接続体を接触させてよい。接続工程では、被研磨部材の接続面が金属部を有すると共に被接続体の接続面が金属部を有する場合、金属部同士を接触させてよい。金属部は、銅を含んでよい。

[0085] 本実施形態に係るデバイス（例えば、半導体デバイス等の電子デバイス）は、本実施形態に係る研磨方法により研磨された被研磨部材、及び、本実施形態に係る部品からなる群より選ばれる少なくとも一種を備える。

実施例

[0086] 以下、本開示を実施例に基づいて具体的に説明するが、本開示は当該実施例に限定されるものではない。

[0087] <研磨液の調製>

表1～4の各成分、及び、蒸留水を混合することにより、各表の組成を有する研磨液を得た。各表は、研磨液の全質量を基準とした各成分の含有量（単位：質量％）を示しており、残部は蒸留水である。砥粒としては、セリウム酸化物粒子（昭和電工マテリアルズ株式会社製、商品名：HS-8005）又はコロイダルシリカ（扶桑化学工業株式会社製、商品名：PL-3）を用いた。コロイダルシリカの含有量は、固形分であるシリカ粒子の含有量である。「MMB」は3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノールを意味し、「HBTA」は1-ヒドロキシベンゾトリアゾールを意味する。ポリグリセリンとしては、阪本薬品工業株式会社製の商品名「PGL750」（グリセリン10量体、重量平均分子量：750、水酸基価：870～910）を用いた。

[0088] <砥粒の平均粒径>

マイクロトラック・ベル株式会社製の「Microtrak MT3300EXII」を用いて、各実施例の研磨液における砥粒の平均粒径を求めた。各実施例において、平均粒径D50は341nmであり、平均粒径D80は609nmであった。

[0089] <研磨液のpH>

pHメータ（東亜ディーケーケー株式会社製の型番：PHL-40）を用いて研磨液のpHを測定した。フタル酸塩pH緩衝液（pH：4.01）及び中性リン酸塩pH緩衝液（pH：6.86）を標準緩衝液として用いてpHメータを2点校正した後、pHメータの電極を研磨液に入れ、2分以上経過して安定した後の値を測定した。結果を各表に示す。

[0090] <研磨評価>

銅の研磨速度を評価するための基体として、 $\phi 300$ mmシリコンウエハ上に形成された銅膜を有する基体を準備した。研磨装置（APPLIED MATERIALS社製、商品名：Reflexion LK）において、吸着パッドを貼り付けた基体取り付け用のホルダーに基体を取り付けた。多

孔質ウレタン樹脂製のパッドを貼り付けた定盤上に、被研磨面がパッドに対向するようにホルダーを載せた。上述の研磨液を供給量 350 mL/min でパッド上に供給しながら、研磨荷重 4 psi で基体をパッドに押し当てた。このとき、定盤を 147 min⁻¹、ホルダーを 153 min⁻¹で1分間回転させて研磨を行った。研磨後の基体を純水でよく洗浄した後に乾燥させた。金属膜厚測定器（日立国際電気株式会社製、商品名：VR-120/08S）を用いて銅膜の研磨前後の膜厚変化を測定して銅の研磨速度（Cu-RR）を求めた。基体の中心を通過する線（直径）上において等間隔に位置する65点の厚さを測定し、その平均値を銅膜の厚さとして得た。結果を各表に示す。

[0091] 各実施例では、セリウム酸化物を含む砥粒を用いていない比較例1、アンモニウム塩を用いていない比較例2、3、及び、pHが9.00以上ではない比較例4、5と比較して優れた研磨速度が得られていることが確認される。

[0092] [表1]

		実施例											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
組成	セリウム酸化物粒子	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	炭酸アンモニウム	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
	アンモニア					0.30							
	MMB	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.305					
	ポリグリセリン	1	1	1	1	1	1	1					
	1-プロパノール								1.333				
	ヘキシレングリコール									1.333			
	1,3-ブタンジオール										1.333		
	2-プロパノール											1.333	
	リンゴ酸							0.01					
	グリシン							0.4					
	HBTA				0.010	0.008			0.025				
	水酸化カリウム	0.48	0.24		0.48			0.48					
pH	9.93	9.39	9.24	9.70	10.50	9.56	9.13	9.79	9.81	9.86	9.84	9.87	
Cu-RR [$\mu\text{m}/\text{min}$]	0.64	0.90	0.75	0.68	0.62	0.58	0.61	0.76	0.76	0.75	0.64	0.49	

[0093]

[表2]

		実施例						
		13	14	15	16	17	18	19
組成	セリウム酸化物粒子	1	1	1	1	1	1	1
	炭酸アンモニウム	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	1.69	1.69
	過硫酸アンモニウム				0.60	0.80		
	アンモニア		0.15					
	MMB	0.333	0.333	0.305	0.305	0.305	0.333	0.333
	ポリグリセリン	1	1	1	1	1	1	1
	リンゴ酸	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	グリシン	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	HBTA			0.025	0.025	0.025		
	水酸化カリウム	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
pH		9.89	10.10	9.82	9.41	9.33	9.47	9.52
Cu-RR [$\mu\text{m}/\text{min}$]		0.40	0.65	0.40	1.08	1.32	0.56	0.42

[0094] [表3]

		実施例									
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
組成	セリウム酸化物粒子	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	過硫酸アンモニウム	0.80	0.80								
	酢酸アンモニウム		0.02	0.02	1.36						
	炭酸水素アンモニウム					1.39					
	硫酸アンモニウム						1.16	0.10			
	塩化アンモニウム								0.94		
	リン酸二水素アンモニウム									1.16	0.10
	アンモニア	0.15	0.30	0.30				0.30			0.30
	MMB		0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
	ポリグリセリン		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	リンゴ酸	0.01									
	グリシン	0.4									
	HBTA	0.030	0.008	0.008				0.008			0.008
	水酸化カリウム	0.48			0.48	0.48	0.48		0.48	0.48	
pH		9.97	10.67	10.89	9.61	9.30	9.47	10.36	9.51	9.71	10.24
Cu-RR [$\mu\text{m}/\text{min}$]		1.22	1.21	0.40	0.44	0.63	0.84	0.41	0.45	0.64	0.40

[0095]

[表4]

		比較例				
		1	2	3	4	5
組成	セリウム酸化物粒子		1	1	1	1
	コロイダルシリカ	1				
	炭酸アンモニウム	0.42			1.69	
	炭酸水素アンモニウム					0.70
	MMB	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
	ポリグリセリン	1		1	1	1
	リンゴ酸	0.01	0.01	0.01	0.01	
	グリシン	0.4	0.4		0.4	
	HBTA					0.008
	水酸化カリウム	0.48	0.48	0.48		
pH		9.82	12.16	12.92	8.56	7.99
Cu-RR [$\mu\text{m}/\text{min}$]		0.31	0.09	0.06	0.26	0.31

請求の範囲

- [請求項1] セリウム酸化物を含む砥粒と、アンモニウム塩と、を含有し、
pHが9.00以上である、研磨液。
- [請求項2] 前記アンモニウム塩が炭酸アンモニウムを含む、請求項1に記載の
研磨液。
- [請求項3] 前記アンモニウム塩が過硫酸アンモニウムを更に含む、請求項2に
記載の研磨液。
- [請求項4] 前記アンモニウム塩の含有量が0.3～2質量%である、請求項1
に記載の研磨液。
- [請求項5] アンモニアを更に含有する、請求項1に記載の研磨液。
- [請求項6] ヒドロキシ基を有するエーテル化合物を更に含有する、請求項1に
記載の研磨液。
- [請求項7] 前記エーテル化合物がアルコキシアルコールを含む、請求項6に記
載の研磨液。
- [請求項8] 前記アルコキシアルコールが3-メトキシ-3-メチル-1-ブタ
ノールを含む、請求項7に記載の研磨液。
- [請求項9] 前記アルコキシアルコールの含有量が、研磨液の全質量を基準とし
て0.2～0.8質量%である、請求項7に記載の研磨液。
- [請求項10] 前記エーテル化合物が、2つ以上のヒドロキシ基を有する化合物を
含む、請求項6に記載の研磨液。
- [請求項11] 前記エーテル化合物がポリエーテルを更に含む、請求項7に記載の
研磨液。
- [請求項12] 前記ポリエーテルがポリグリセリンを含む、請求項11に記載の研
磨液。
- [請求項13] 前記ポリエーテルの含有量が、研磨液の全質量を基準として0.5
～3質量%である、請求項11に記載の研磨液。
- [請求項14] pHが9.00～11.00である、請求項1に記載の研磨液。
- [請求項15] 請求項1～14のいずれか一項に記載の研磨液を用いて、銅を含有

する被研磨部材を研磨する、研磨方法。

[請求項16] 請求項15に記載の研磨方法により研磨された被研磨部材を用いて部品を得る、部品の製造方法。

[請求項17] 請求項15に記載の研磨方法により研磨された被研磨部材を用いて半導体部品を得る、半導体部品の製造方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2022/032453

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
<i>H01L 21/304</i> (2006.01)i; <i>B24B 37/00</i> (2012.01)i; <i>C09G 1/02</i> (2006.01)i; <i>C09K 3/14</i> (2006.01)i FI: H01L21/304 622D; B24B37/00 H; C09G1/02; C09K3/14 550D; C09K3/14 550Z; H01L21/304 622W		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) H01L21/304; B24B37/00; C09G1/02; C09K3/14		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Published examined utility model applications of Japan 1922-1996 Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2022 Registered utility model specifications of Japan 1996-2022 Published registered utility model applications of Japan 1994-2022		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	WO 2011/122415 A1 (ASAHI GLASS CO., LTD.) 06 October 2011 (2011-10-06) paragraphs [0045]-[0083], [0103]	1, 4-7, 9, 14-17 2, 3, 8, 10-13
X A	WO 2012/165016 A1 (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.) 06 December 2012 (2012-12-06) paragraphs [0028]-[0062], [0078], [0079], [0092]-[0094]	1, 4, 5, 14-17 2, 3, 6-13
X A	JP 10-094955 A (NISSAN CHEM. IND., LTD.) 14 April 1998 (1998-04-14) paragraphs [0026]-[0036], [0042]	1, 4, 5, 14-17 2, 3, 6-13
X A	WO 2005/110679 A1 (NISSAN CHEM. IND., LTD.) 24 November 2005 (2005-11-24) paragraphs [0020]-[0025], [0064]-[0070]	1, 4, 14-17 2, 3, 5-13
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 28 September 2022		Date of mailing of the international search report 11 October 2022
Name and mailing address of the ISA/JP Japan Patent Office (ISA/JP) 3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915 Japan		Authorized officer Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2022/032453

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2016/0068711 A1 (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 10 March 2016 (2016-03-10)	1, 4, 14
A	paragraphs [0083]-[0100]	2, 3, 5-13, 15-17
X	JP 2019-057615 A (FUJIMI INC.) 11 April 2019 (2019-04-11)	1-7, 9-17
A	paragraphs [0002], [0003], [0026]-[0035], [0041]-[0047], [0063]-[0067]	8
A	JP 2002-043259 A (ASAHI KASEI CORP.) 08 February 2002 (2002-02-08)	1-17
	paragraphs [0001]-[0003], [0009]-[0013], [0019]-[0021]	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/JP2022/032453

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
WO	2011/122415	A1	06 October 2011	US 2013/0029489 A1 paragraphs [0023]-[0063], [0085]	
				EP 2555229 A1	
				CN 102822308 A	
				SG 184276 A	
				KR 10-2013-0016265 A	
				TW 201142000 A	
WO	2012/165016	A1	06 December 2012	KR 10-2013-0135384 A paragraphs [0028]-[0074], [0094]-[0098], [0140]-[0142]	
				TW 201249975 A	
JP	10-094955	A	14 April 1998	US 5962343 A column 10, line 29 to column 11, line 48, column 16, lines 1-21	
				US 6372003 B1	
				EP 822164 A2	
				EP 947469 A2	
WO	2005/110679	A1	24 November 2005	US 2007/0240366 A1 paragraphs [0041]-[0046], [0088]-[0100]	
				EP 1747849 A1	
				KR 10-2007-0033360 A	
				CN 1953842 A	
				TW 200600455 A	
US	2016/0068711	A1	10 March 2016	WO 2014/171766 A1 paragraphs [0183]-[0206]	
				KR 10-2014-0125316 A	
				TW 201500531 A	
				CN 105143390 A	
JP	2019-057615	A	11 April 2019	(Family: none)	
JP	2002-043259	A	08 February 2002	(Family: none)	

<p>A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））</p> <p>H01L 21/304(2006.01)i; B24B 37/00(2012.01)i; C09G 1/02(2006.01)i; C09K 3/14(2006.01)i FI: H01L21/304 622D; B24B37/00 H; C09G1/02; C09K3/14 550D; C09K3/14 550Z; H01L21/304 622W</p>																	
<p>B. 調査を行った分野</p> <p>調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））</p> <p>H01L21/304; B24B37/00; C09G1/02; C09K3/14</p> <p>最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの</p> <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922 - 1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971 - 2022年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996 - 2022年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994 - 2022年</td> </tr> </table> <p>国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）</p>			日本国実用新案公報	1922 - 1996年	日本国公開実用新案公報	1971 - 2022年	日本国実用新案登録公報	1996 - 2022年	日本国登録実用新案公報	1994 - 2022年							
日本国実用新案公報	1922 - 1996年																
日本国公開実用新案公報	1971 - 2022年																
日本国実用新案登録公報	1996 - 2022年																
日本国登録実用新案公報	1994 - 2022年																
<p>C. 関連すると認められる文献</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>引用文献の カテゴリー*</th> <th>引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示</th> <th>関連する 請求項の番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X A</td> <td>WO 2011/122415 A1 (旭硝子株式会社) 06.10.2011 (2011 - 10 - 06) 段落 [0045] - [0083], [0103]</td> <td>1,4-7,9,14-17 2,3,8,10-13</td> </tr> <tr> <td>X A</td> <td>WO 2012/165016 A1 (日立化成株式会社) 06.12.2012 (2012 - 12 - 06) 段落 [0028] - [0062], [0078], [0079], [0092] - [0094]</td> <td>1,4,5,14-17 2,3,6-13</td> </tr> <tr> <td>X A</td> <td>JP 10-094955 A (日産化学工業株式会社) 14.04.1998 (1998 - 04 - 14) 段落 [0026] - [0036], [0042]</td> <td>1,4,5,14-17 2,3,6-13</td> </tr> <tr> <td>X A</td> <td>WO 2005/110679 A1 (日産化学工業株式会社) 24.11.2005 (2005 - 11 - 24) 段落 [0020] - [0025], [0064] - [0070]</td> <td>1,4,14-17 2,3,5-13</td> </tr> </tbody> </table> <p><input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input checked="" type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。</p> <p>* 引用文献のカテゴリー “A” 特に関連のある文献ではなく、一般的な技術水準を示すもの “E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの “L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） “O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 “P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献 “T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの “X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの “Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの “&” 同一パテントファミリー文献</p>			引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号	X A	WO 2011/122415 A1 (旭硝子株式会社) 06.10.2011 (2011 - 10 - 06) 段落 [0045] - [0083], [0103]	1,4-7,9,14-17 2,3,8,10-13	X A	WO 2012/165016 A1 (日立化成株式会社) 06.12.2012 (2012 - 12 - 06) 段落 [0028] - [0062], [0078], [0079], [0092] - [0094]	1,4,5,14-17 2,3,6-13	X A	JP 10-094955 A (日産化学工業株式会社) 14.04.1998 (1998 - 04 - 14) 段落 [0026] - [0036], [0042]	1,4,5,14-17 2,3,6-13	X A	WO 2005/110679 A1 (日産化学工業株式会社) 24.11.2005 (2005 - 11 - 24) 段落 [0020] - [0025], [0064] - [0070]	1,4,14-17 2,3,5-13
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号															
X A	WO 2011/122415 A1 (旭硝子株式会社) 06.10.2011 (2011 - 10 - 06) 段落 [0045] - [0083], [0103]	1,4-7,9,14-17 2,3,8,10-13															
X A	WO 2012/165016 A1 (日立化成株式会社) 06.12.2012 (2012 - 12 - 06) 段落 [0028] - [0062], [0078], [0079], [0092] - [0094]	1,4,5,14-17 2,3,6-13															
X A	JP 10-094955 A (日産化学工業株式会社) 14.04.1998 (1998 - 04 - 14) 段落 [0026] - [0036], [0042]	1,4,5,14-17 2,3,6-13															
X A	WO 2005/110679 A1 (日産化学工業株式会社) 24.11.2005 (2005 - 11 - 24) 段落 [0020] - [0025], [0064] - [0070]	1,4,14-17 2,3,5-13															
国際調査を完了した日	28.09.2022	国際調査報告の発送日	11.10.2022														
名称及びあて先	日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	権限のある職員（特許庁審査官）	齋藤 正貴 50 4051 電話番号 03-3581-1101 内線 3559														

C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリ*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X A	US 2016/0068711 A1 (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 10.03.2016 (2016 - 03 - 10) 段落 [0083] - [0100]	1,4,14 2,3,5-13,15-17
X A	JP 2019-057615 A (株式会社フジインコーポレーテッド) 11.04.2019 (2019 - 04 - 11) 段落 [0002], [0003], [0026] - [0035], [0041] - [0047], [0063] - [0067]	1-7,9-17 8
A	JP 2002-043259 A (旭化成株式会社) 08.02.2002 (2002 - 02 - 08) 段落 [0001] - [0003], [0009] - [0013], [0019] - [0021]	1-17

国際調査報告
 パテントファミリーに関する情報

国際出願番号

PCT/JP2022/032453

引用文献			公表日	パテントファミリー文献	公表日
WO	2011/122415	A1	06.10.2011	US 2013/0029489 A1 段落 [0023] - [0063], [0085] EP 2555229 A1 CN 102822308 A SG 184276 A KR 10-2013-0016265 A TW 201142000 A	
WO	2012/165016	A1	06.12.2012	KR 10-2013-0135384 A 段落 [0028] - [0074], [0094] - [0098], [0140] - [0142] TW 201249975 A	
JP	10-094955	A	14.04.1998	US 5962343 A 第10欄第29行目-第11欄第48行目, 第16欄第1行目-第21行目 US 6372003 B1 EP 822164 A2 EP 947469 A2	
WO	2005/110679	A1	24.11.2005	US 2007/0240366 A1 段落 [0041] - [0046], [0088] - [0100] EP 1747849 A1 KR 10-2007-0033360 A CN 1953842 A TW 200600455 A	
US	2016/0068711	A1	10.03.2016	WO 2014/171766 A1 段落 [0183] - [0206] KR 10-2014-0125316 A TW 201500531 A CN 105143390 A	
JP	2019-057615	A	11.04.2019	(ファミリーなし)	
JP	2002-043259	A	08.02.2002	(ファミリーなし)	